



211 護銅劑

§ 產品說明

211 護銅劑，用於 PCB 外層專門的添加劑，可以保護電鍍銅鍍層，製程過程銅面不易氧化，對於外層板可減少銅面氧化造成之不良。尤其更適用高密度板子，如 HDI、CSP 等細線路、窄間距之高級板。

§ 物 性

外觀	無色~淡黃色液體
比重	0.95~1.05
PH	>9
閃點	不可燃

§ 操作條件

溫 度	20~40℃
213 錫鉛保護劑	1%
H2O	加到液位線
攪 拌	需 要
過 濾	連續攪拌